

2023年7月3日
株式会社ニッケンハードウェア
代表取締役 岡本 秀樹

東京都発行の「東京ソーシャルボンド」への投資について

株式会社ニッケンハードウェア 代表取締役岡本秀樹、以下「当社」は、このたび東京都が発行する「東京ソーシャルボンド」(*)へ投資する事を決定しました。

東京ソーシャルボンド発行による調達資金は、社会的に支援が必要な人々を対象とする東京都の事業に充当されます。今回債の調達資金は、「児童福祉施設等の整備」、「公共施設のバリアフリー化・ユニバーサルデザイン化」に充当される予定です。

東京ソーシャルボンドへの投資を通じて、収益性の確保のみならず、社会的な課題を解決する施策への貢献も果たしてまいります。当該ソーシャルボンドの資金は、社会的に支援が必要な人々を対象とする事業へ充当される予定です。当該債券を購入することで、SDGs 実現につながるものと考えております。引き続き当社はE S G投融資を通じて、持続可能な社会の実現に向けて、社会的責任を果たしてまいります。

(*)ソーシャルボンドは、社会的課題解決に要する資金を調達するために発行する債券です。

東京ソーシャルボンドは国際資本市場協会 (International Capital Market Association : ICMA) が定義する「ソーシャルボンド」の特性に従った債券である旨、セカンド・パーティー・オピニオンを取得しています (セカンド・パーティー・オピニオン発行者: R&I)。